



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓 (6488TT)

2026 年第一季營運報告

2026/05/05





Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

01

經營團隊重點報告

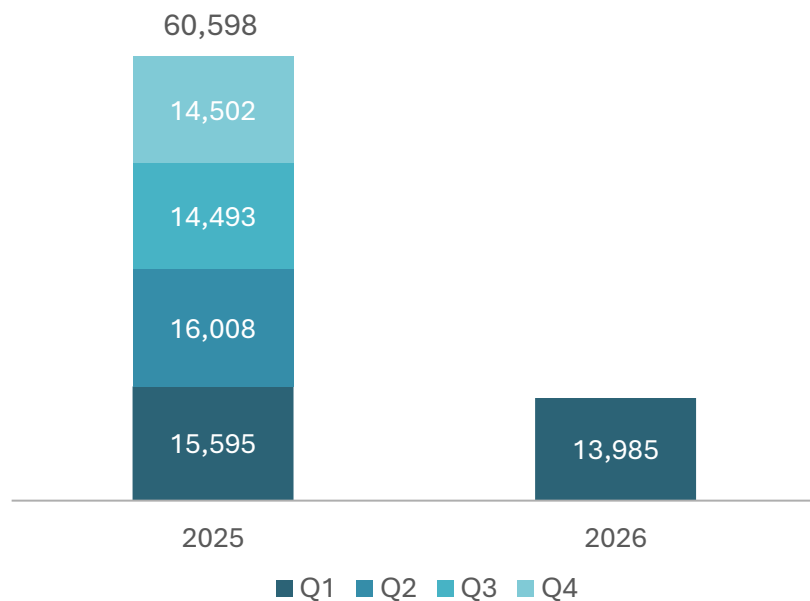
經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

營業收入

- 2026年第一季 → 新台幣 140 億元 · 季減 3.57%

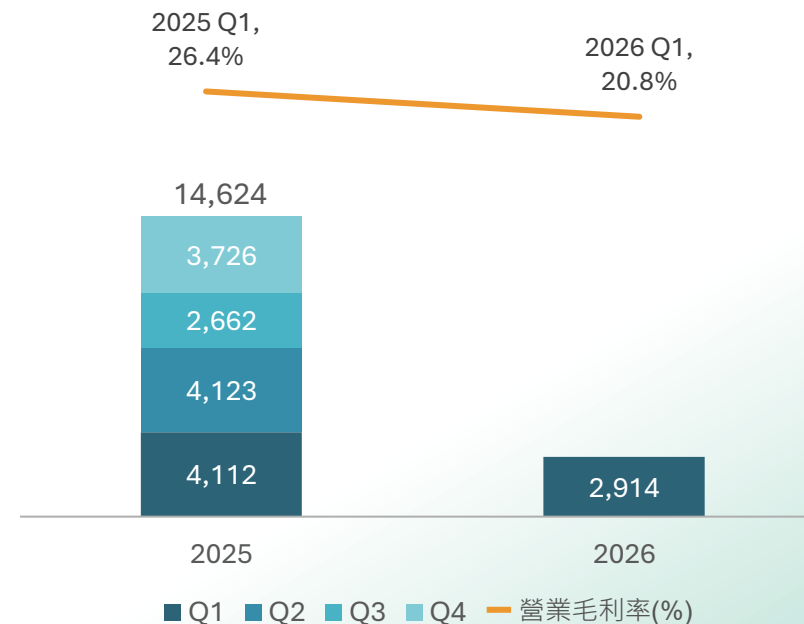
(新台幣百萬元)



營業毛利率

- 2026年第一季 → 20.8%

(新台幣百萬元)



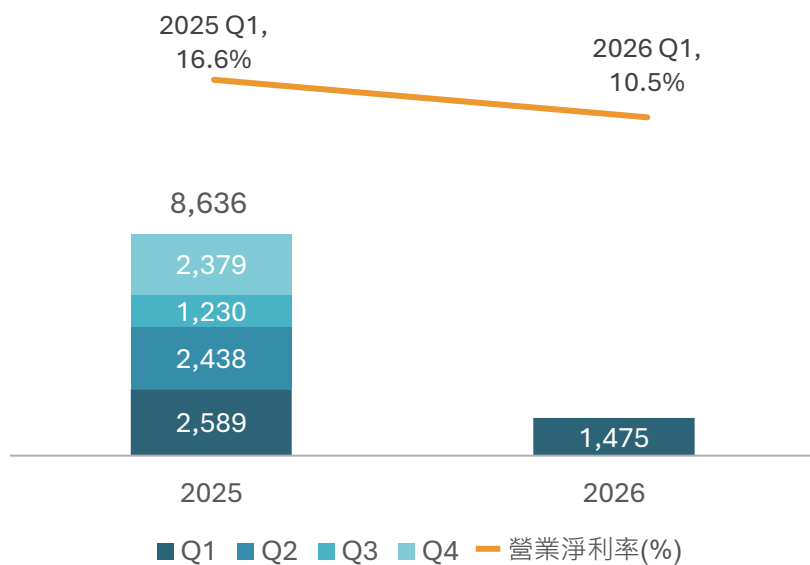
經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

營業淨利率

- 2026年第一季 → 10.5%

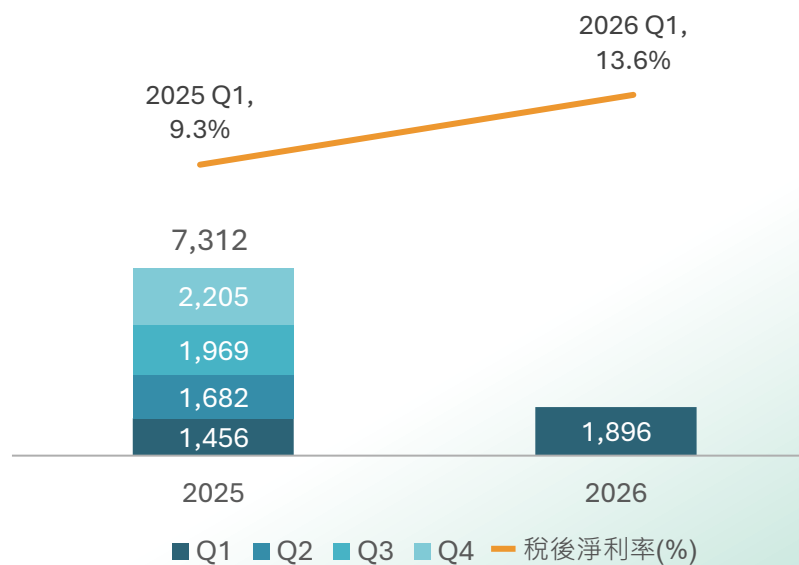
(新台幣百萬元)



稅後淨利率

- 2026年第一季 → 13.6%

(新台幣百萬元)



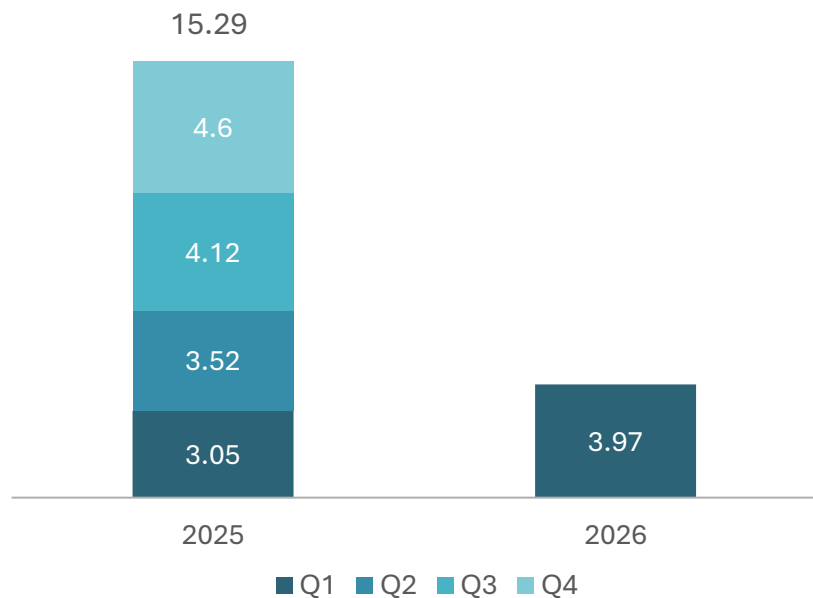
經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

每股盈餘

- 2026年第一季 → 新台幣 3.97 元

(NT\$)



預收貨款

- 新台幣235億元 (美金7.4億元)¹



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ AI驅動結構性需求成為長期展望支柱，短期逆風仍存

- ✓ **總體環境審慎樂觀**：全球經濟成長仍維持正向，但復甦步調不均。儘管2026年GDP預測略有下修，AI基礎建設投資仍為消費性終端市場疲弱提供重要支撐。投入成本壓力與貿易政策不確定性持續影響短期需求，不過主要央行貨幣政策轉向寬鬆，亦帶來部分緩衝。與此同時，地緣政治緊張局勢、貿易與關稅政策變化、能源、運輸及原物料成本波動、匯率變動，以及更廣泛的總體經濟不確定性，仍是可能影響復甦速度與能見度的外部變數。我們將持續密切關注這些發展，並以審慎且有紀律的方式應對與管理。
- ✓ **運算與記憶體需求受AI結構性動能支撐**：AI工作負載正由內容生成進一步朝代理型AI (Agentic AI) 演進，帶動運算需求持續擴大，並在更廣泛的客戶基礎下，支撐先進矽晶圓的長期需求。記憶體需求亦由高階伺服器延伸至系統層級與終端裝置應用，進一步拓展矽晶圓可服務市場。
- ✓ **消費性電子由量轉值，車用需求逐步擺脫景氣循環影響**：在出貨量承壓與成本上升環境下，智慧型手機與PC產業正轉向高ASP、AI賦能產品，以價值提升而非出貨成長支撐營收。車用半導體需求亦逐步與短期車市銷售波動脫鉤，在電動化與軟體定義架構推動下，單一車輛矽含量持續提升，帶動結構性成長。
- ✓ **先進封裝供給緊俏支撐晶圓需求能見度**：先進封裝已成為提升半導體效能的重要關鍵環節，相關產能供給仍維持緊俏，領先晶片設計業者亦積極擴充自有封裝能力。此趨勢持續帶動先進與特殊矽晶圓需求，並提供公司更長期的訂單能見度。



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ 環球晶圓掌握 AI 趨勢驅動的結構性成長機會

- ✓ **AI驅動結構性轉變支撐需求**：AI應用自資料中心延伸至邊緣裝置與終端應用，正重塑半導體需求結構，帶動先進製程與先進封裝發展，提升單一裝置矽含量，並支撐高階晶圓需求。隨著AI應用進一步擴展至更廣泛應用，部分成熟製程需求亦逐步回溫。然而，整體復甦節奏仍不均衡，在總體經濟不確定性持續下，後續展望仍需審慎觀察。
- ✓ **各尺寸稼動穩健，成熟製程需求逐步改善**：受AI與高效能運算需求帶動，除了仍在產能爬坡中的新增產能之外，既有12吋晶圓產線維持滿載；8吋晶圓稼動率亦維持穩健，主要受電源管理與類比等應用支撐，並有望進一步帶動6吋產品，促使中小尺寸晶圓需求穩步回升。
- ✓ **高附加價值產品布局推進，SOI、GaN與SiC展現進展**：SOI產線表現亮眼，儘管仍處擴產初期，已展現正毛利，成為集團成長布局中率先顯現成果的亮點之一。同時，GaN產能維持滿載，擴產持續推進（30%已完成、20%進行中）；12吋SiC則持續推進客戶驗證進程，為未來高附加價值成長機會奠定基礎。
- ✓ **區域布局優勢、財務紀律與政策支持並進**：歐洲市場展現相對韌性，隨義大利廠產能逐步放量、主要設備安裝大致完成，營運動能可望逐步增強。同時，環球晶圓已開始於美國與歐洲陸續取得政府相關補助，支持公司長期發展。公司基本面亦持續改善，隨需求回溫帶動營收與現金流成長，負債水位已過高峰，銀行借款明顯下降，資產負債表結構持續強化。

終端市場趨勢顯示成長具結構性支撐， 超越景氣循環復甦



運算與
AI 基礎建設



結構性韌性

- 產業正由生成式 AI 邁向代理型 AI (Agentic AI) 的轉型，結構性推升 token 使用量，並持續帶動 AI 基礎建設投資，進一步強化對先進半導體技術的長期需求；在技術持續差異化與客戶基礎擴大的支撐下，相關成長動能可望延續。



記憶體市場



穩健基本面

- 隨著工作負載由單純生成式 AI 進一步演進至自主代理型 AI，基礎設施瓶頸也正由以 GPU 為核心的算力需求，轉向多步驟邏輯推理與協作調度能力，帶動記憶體與儲存需求由高頻寬記憶體 (HBM) 延伸至系統層級的記憶體與儲存架構，以支援持續性情境記憶、系統調度，以及裝置端代理型 AI 處理。



智慧型手機與
個人電腦



價值導向需求

- 在出貨量下滑與物料成本上升背景下，市場正加速朝高階化策略發展，聚焦具 AI 功能的高階 PC 與旗艦裝置，以緩解低階市場壓力。雖然較明顯的出貨回升仍偏向中長期發展結果，但終端裝置 AI 換機需求、新型態產品，以及客製化應用處理器滲透率提升，仍可望提供增量支撐。

終端市場趨勢顯示成長具結構性支撐， 超越景氣循環復甦 (續)



車用與工業應用



溫和復甦

- 類比與功率半導體需求正逐步回溫。隨軟體定義架構與電動化趨勢推進，單一車輛矽含量持續提升，使產業營收成長結構性地逐步與整車出貨循環脫鉤。



先進封裝



價值創造的核心引擎

- 先進封裝已成為推動半導體擴展的重要驅動力，支撐 AI 加速器效能提升。在供應緊張背景下，領先晶片設計業者正加速將封裝能力內製化，儘管散熱管理等技術挑戰仍在。隨系統複雜度持續提高，也進一步帶動先進與特殊晶圓需求，提升中長期需求能見度，並支撐先進產能維持穩健稼動。

02

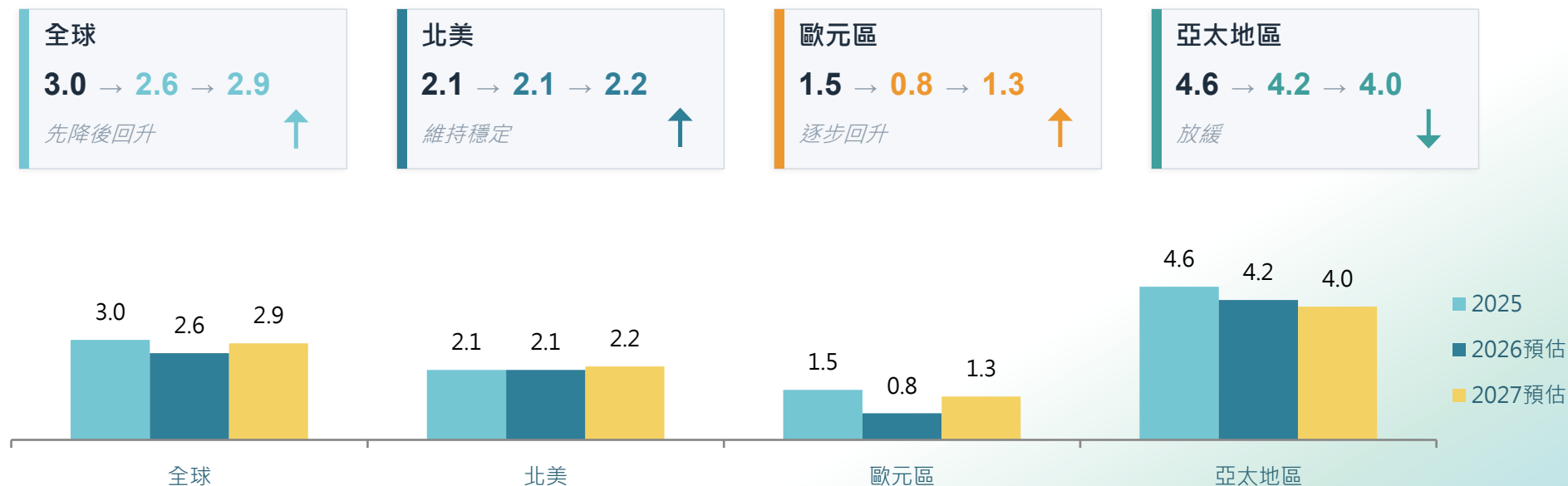
產業概況

短期總體逆風猶存，結構性動能提供支撐

- **全球 GDP 預測下修**：受中東衝突增添市場波動影響，2026 年全球經濟成長預測下修至 2.6% 至 3.4% 區間。
- **通膨壓力仍存**：儘管主要經濟體整體通膨已有所緩和，能源、原物料與勞動成本等投入成本壓力仍在，持續對企業獲利與終端市場需求形成壓力。
- **市場韌性支撐因素**：正向來看，持續性的**科技投資**，尤其是 **AI 基礎建設投入**，結合民間部門的**調適能力**，預期將對貿易政策變動所帶來的逆風提供具意義的部分抵銷，形成支撐。

實質 GDP 成長預測 (%)

GDP 成長趨勢：2025 → 2026 預估 → 2027 預估

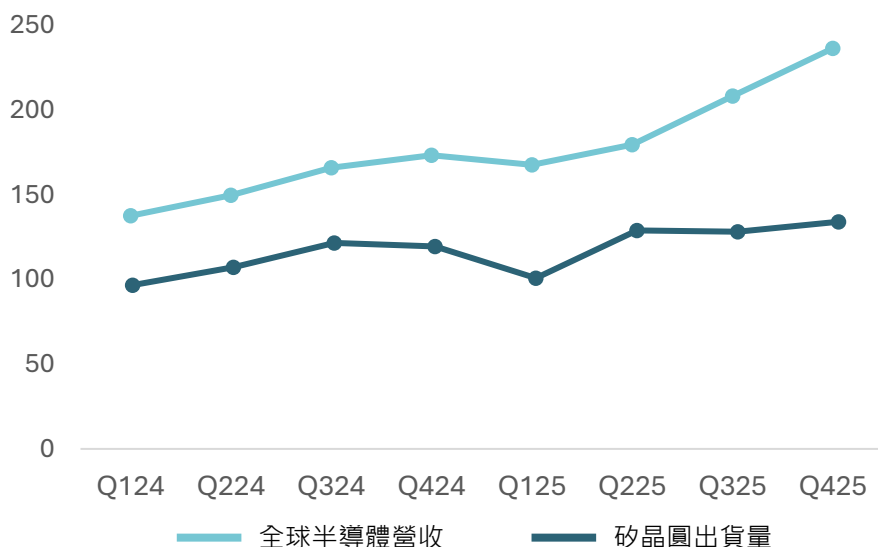


全球半導體產業趨勢

- **結構性需求成長支撐下，晶圓出貨逐步回溫：**全球半導體營收持續呈現上升趨勢，受 AI 與高效能運算帶動的結構性需求支撐。儘管矽晶圓出貨曾出現短期波動，自 2025 年初以來已逐步止穩並恢復溫和成長，整體走勢持續改善。
- **庫存去化持續推進：**儘管客戶營收已有回升，庫存正常化仍在進行中，平均庫存天數正以溫和步調下降。隨庫存水位逐步回到較健康區間，晶圓需求可望進一步回升，支撐產業朝漸進且更穩定的復甦方向發展。

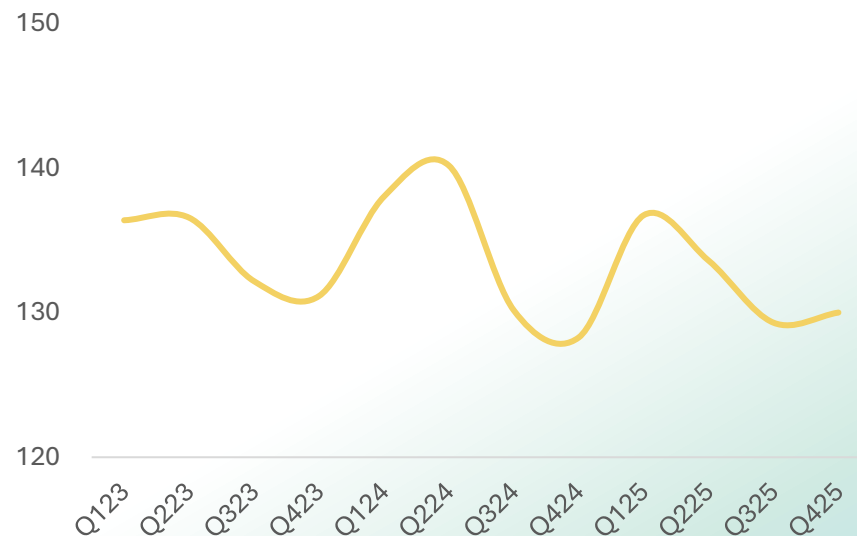
全球半導體營收 vs. 矽晶圓出貨量¹

(百萬平方英寸 / 季)
(十億美元)



環球晶圓全球客戶平均庫存天數²

(天數)



AI 驅動需求支撐 12 吋晶圓需求能見度

- **AI 需求帶動 12 吋晶圓產能趨緊**：AI 應用快速成長推升先進製程與更複雜封裝需求，提高單一裝置晶圓用量，並結構性強化 12 吋晶圓需求。受此帶動，環球晶圓 12 吋產能維持高稼動，尤其先進製程相關需求表現更為強勁。
- **12 吋晶圓需求能見度具上行空間**：12 吋晶圓需求維持強勁，且能見度穩健。在此基礎下，環球晶圓持續擴充 12 吋產能，該產品占比預期將由約五成提升至接近三分之二。依客戶已公開規劃，美國 12 吋晶圓產能於 2026 至 2030 年間有機會成長約 50%，以支應中長期需求。
- **小尺寸晶圓需求逐步回溫**：8 吋產品在電源管理與類比應用支撐下，持續維持高稼動。憑藉彈性產能配置以因應多元客戶需求，環球晶圓出貨動能維持穩健。隨庫存正常化持續推進，8 吋產品穩健表現可望進一步帶動 6 吋晶圓市場復甦。

環球晶圓全球擴產最新進展

日本

已迅速走出擴產相關壓力，開始貢獻獲利、毛利改善及正向現金流

義大利

新產線已通過 IATF 16949 認證，並持續推進客戶驗證

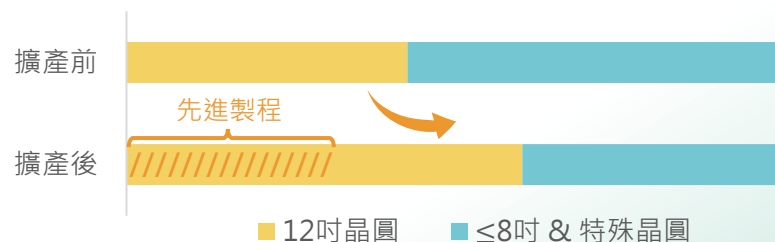
美國
(德州)

設備安裝與產線建置持續推進，並由關鍵客戶驗證帶動產能逐步放量

美國
(密蘇里州)

部分射頻與矽光子產品已於 2026 年第一季開始量產

環球晶圓產品組合預估



高平均銷售單價(ASP)
特殊產品組合

長期需求能見度佳

掌握化合物半導體結構性成長機會

- **高附加價值轉型驅動成長**：根據 Yole Group，化合物半導體市場規模預計自 2025 至 2031 年將成長逾一倍，年複合成長率約 14%。此成長主要受高效率與高頻性能優勢帶動，反映應用正朝高附加價值方向進行結構性轉型。
- **GaN 策略聚焦高效能功率應用**：環球晶圓持續拓展氮化鎵 (GaN) 解決方案，布局資料中心、充電基礎設施與智慧裝置等高效率功率應用市場，需求能見度穩健。公司在晶格失配 (lattice mismatch) 管理具備深厚技術基礎，並持續累積專利布局，共同鞏固競爭優勢。目前 GaN 產能維持滿載，約 30% 擴產已完成，另有約 20% 產能擴充持續推進中。
- **SiC 策略轉向高附加價值應用**：環球晶圓正推動碳化矽 (SiC) 布局朝更高附加價值應用轉型，同時維持對既有產品與客戶的持續支援。新開發方向涵蓋應用於散熱、先進封裝及特定光學領域的 12 吋 SiC，並藉由自有長晶技術與先進晶圓製程能力，建立有別於傳統功率元件市場的差異化優勢。

擴展 GaN、推進 SiC，布局次世代功率應用

GaN



1

滿載稼動

2

產能擴充

- 約 30% 已完成
- 約 20% 推進中

3

潛在應用

- AI 電源效率應用
- 先進穿戴裝置

SiC



1

12吋 SiC

2

送樣驗證階段

3

潛在應用

- 散熱應用
- 先進封裝
- 先進穿戴裝置

03

營運概況



財務摘要：2026年第一季 vs. 2025年第四季 vs. 2025年第一季

(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘)	2026年第一季	2025年第四季	2025年第一季	季成長	年成長
營業收入	13,985	14,502	15,595	-3.6%	-10.3%
營業毛利 %	20.8%	25.7%	26.4%	-4.9p.p.	-5.6p.p.
營業淨利	1,475	2,379	2,589	-38.0%	-43.0%
營業淨利 %	10.5%	16.4%	16.6%	-5.9p.p.	-6.1p.p.
本期淨利	1,896	2,205	1,456	-14.0%	30.2%
本期淨利 %	13.6%	15.2%	9.3%	-1.6p.p.	4.3p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$3.97	NT\$4.60	NT\$3.05	-NT\$0.63	NT\$0.92
EBITDA* ²	4,060	4,460	4,033	-9.0%	0.7%
EBITDA %	29.0%	30.8%	25.9%	-1.8p.p.	3.1p.p.
EBIT ³	1,855	2,575	1,778	-27.9%	4.4%
股東權益報酬率 (ROE* ⁴ (年化))	8.1%	9.6%	6.4%	-1.5p.p.	1.7p.p.
資產報酬率 (ROA* ⁵ (年化))	4.17%	4.61%	2.6%	-0.4p.p.	1.4p.p.
資本支出 ⁶	3,460	5,826	11,557	-	-
折舊費用	2,199	1,880	2,250	-	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量

2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用

3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息

4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益

5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產

6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款



損益表

新台幣百萬元	2023	2024	2025	Q126	Q126 (模擬) ¹
營業收入	70,651	62,626	60,598	13,985	13,204
成長率 (%) ²	0.5%	-11.4%	-3.2%	-3.6%	-
營業毛利	26,441	19,804	14,624	2,914	4,083
營業毛利率 (%)	37.4%	31.6%	24.1%	20.8% ³	30.9%
EBITDA	30,630	18,010	17,340	4,060	4,730
EBITDA率 (%)	43.4%	28.8%	28.6%	29.0%	35.8%
營業淨利	20,059	14,118	8,636	1,475 ³	2,824
營業淨利率 (%)	28.4%	22.5%	14.3%	10.5%	21.4%
稅前淨利	26,496	12,429	9,516	2,347	3,073
稅前淨利率 (%)	37.5%	19.8%	15.7%	16.8% ⁴	23.3%
稅後淨利	19,770	9,839	7,312	1,896 ⁴	2,373
稅後淨利率 (%)	28.0%	15.7%	12.1%	13.6%	18.0%
每股盈餘 (NT\$)	45.41	21.06	15.29	3.97 ⁴	4.96

備註: 1. 模擬數據排除美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響

2. 成長率係指與去年同期相比的變動幅度 (YoY)

3. 2026年第一季毛利率較前季下滑，主要反映 2025 年第四季認列之一次性因素消退，包括義大利子公司於符合會計認列條件後一次性認列政府補助所帶來的挹注；同時也受到能源、原物料及物流費用上升推升營運成本，以及新擴產據點產能爬坡成本的影響

4. 2026年第一季EPS與稅後淨利較去年同期成長，主要受 Siltronic 持股按市價評價利益挹注



資產負債表

新台幣百萬元	2023	2024	2025	Q126
資產				
現金及約當現金	26,165	38,929	19,484	24,128
應收帳款	10,116	10,265	10,113	10,138
存貨	9,359	11,238	10,399	11,000 ⁶
不動產、廠房及設備	72,251	119,074	107,241	108,861
其他資產	71,097	45,074	71,105	56,910 ⁴
資產總計	188,988	224,581	218,343	211,037

現金資產細項包含:	
(新台幣百萬元)	Q126
三個月以上定存	9,208
受限制現金	8,865
債券	6,367

負債				
短期借款 ¹	40,000	28,797	31,010	33,887
應付帳款	5,027	5,371	4,161	3,867
長期借款 ²	14,542	37,678	43,244	29,221 ³
其他負債	62,966	61,706	46,632	50,683 ⁵
負債總計	122,534	133,553	125,048	117,657

權益總計	66,454	91,028	93,295	93,379
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

備註: 1. 短期借款包括短期借款、應付短期票券，以及一年內或一營業週期內到期的長期借款、應付公司債與應付可轉換公司債
 2. 長期借款包括長期借款、應付公司債及應付海外附認股權公司債
 3. 2026年第一季長期借款較前季下降，主要因海外附認股權公司債 (EB) 及海外附認股權公司債 (FRCP) 到期後重分類至流動負債
 4. 2026年第一季其他資產較前季下降，主要因AMIC補助應收款收現
 5. 2026年第一季其他負債較前季增加，主要因發行商業本票
 6. 2026年第一季存貨較前季增加，主要因部分廠區因應後續訂單需求調整生產排程，以及因應地緣政治不確定性進行預防性備貨

04

Q&A